

# 低シリコーン剥離フィルム

# HP-S1

## 特長

低シリコーン剥離処理フィルムで、さまざまな基材に処理することが可能です。耐熱性に優れた特性があります。

## 構成



## 物性データ

項目	単位	代表値
剥離力【31B法】	mN/25mm	1000
接触角	degree	100

## 剥離力測定方法

テープ : 日東No.31B  
速度 : 0.3 m/min  
角度 : 180°  
条件 : 常温で20時間放置後の剥離力（セバ剥離）

※ 上記の数値は代表値であり、保証値ではございません。

※ 上記の数値は、75μm品で測定しております。



株式会社フジコー



0877-28-6111



0877-28-6114

〒763-0092 香川県丸亀市川西町南甲 284番地 2



IP-RL-069

www.fujikoro.jp